



## 投资3.23亿元，住友电木宣布在苏州新建半导体封装材料工厂

更新时间：2022/10/10 14:49:32

【字体：   】

日本半导体材料厂商住友电木（SumitomoBakelite）近日发布消息称，公司决定在中国苏州购买土地并建设新工厂，以提高其半导体封装材料的生产能力。

据介绍，新工厂包括土地、建筑物、生产线和配套设施的总投资约66亿日元（约合人民币3.23亿元），总占地面积约为6万平方米，计划在2023财年完成建筑物和生产线的安装，并于2024财年初开始生产。

住友电木表示，目前“SUMIKON”EME（用于半导体器件封装的环氧塑封料）拥有全球最大的市场份额（约40%）。苏州住友电木于1997年开始生产，为中国客户提供服务。2021年7月，我们通过在现有工厂增加生产线，扩大了生产能力，以满足不断增长的中国市场的客户需求。随着新工厂的建设，我们将进一步扩大公司在中国的市场份额，预计中长期将扩大，并在每个市场建立最佳的供应体系，以进一步加强我们的业务。

据日经新闻网报道，住友电木新工厂的占地面积约为现有工厂的两倍，如果进一步增强生产线，能使中国的产能翻番。

住友电木表示，中国的封装材料消费量占全球的6成，因此计划扩大中国市场。虽然目前出现了半导体市场行情恶化的迹象，但住友电木认为，“在景气和景气不景气的反复之中，市场将持续增长”。

去年11月8日，住友电木曾宣布，因新一代无线通讯网（5G/6G）、物联网（IoT）、数字化转型（DX）等推升全球半导体需求旺盛，加上来自台湾OSAT（委外专业封测代工）的需求复苏，预估台湾市场将呈现长期性成长，因此将投资约33亿日元在台湾子公司——台湾住友培科股份有限公司现有厂区内兴建新厂房，将半导体封装材料产能扩增至当前的2倍。

住友电木台湾新厂房将在2022年3月动工，预计在2023年中期开始进行生产，届时在台湾的半导体封装材料月产能将从现行的700吨倍增到1,400吨。

来源:全球半导体观察

- 上一篇： 21年来首次！佳能扩产光刻机设备！
- 下一篇： 头部厂商持续加码布局，欧洲首座6吋SiC外延衬底生产基地敲定

打印此文 
 收藏此页 
 关闭窗口 
 返回顶部

### 热门文章>>

关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制...  
 国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的...  
**CSIA关于半导体芯片知识产权的公告**  
 英特尔将在11月1日宣布“有针对性的”裁员计划  
 为接口标准再提速 英特尔将推出下一代 Thunderbolt

### 相关文章>>

英特尔将在11月1日宣布“有针对性的”裁员计划  
 为接口标准再提速 英特尔将推出下一代 Thunderbolt  
 三星美国170亿美元建厂计划或再延后，但日本业务却在加速扩张  
**ASML：有望继续向中国出货非EUV光刻机**  
 台积电：元宇宙世界会来临 半导体技术需精进十倍

### 相关政府部门：

中华人民共和国工业和信息化部| 中华人民共和国国家发展和改革委员会| 中华人民共和国科学技术部| 中华人民共和国国家统计局| 中华人民共和国海关总署| 中华人民共和国国家知识产权局 | 国家软件与集成电路促进中心

### 地方协会：

上海市集成电路行业协会| 广东省半导体行业协会| 深圳市半导体行业协会| 天津市集成电路行业协会| 江苏省半导体行业协会| 苏州市集成电路行业协会| 陕西集成电路行业协会| 大连市半导体行业协会

### 综合链接：

上海硅知识产权交易中心| 赛迪顾问股份有限公司| 《中国集成电路》| 《EDN China电子技术设计》| 《电子工程世界》| 《国际电子商情》| 《中国电子报》| 《电子工程专辑》